

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

## 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

### 2021年4月15日投资者关系活动记录表

编号：2021-04-001

<b>投资者关系 活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
<b>参与单位名称 及人员姓名</b>	会议组织者：民生证券、长江证券、国盛证券、天风证券  参与机构：华夏基金、南方基金、天弘基金、工银瑞信基金、鹏华基金、银华基金、华商基金、华泰柏瑞基金、长城基金、平安基金、汇丰晋信基金、诺德基金、金鹰基金、安信基金、九泰基金、创金合信基金、中庚基金、信诚基金、国都基金、光大保德信基金、朱雀基金、前海开源基金、惠升基金、万家基金、博道基金、中信建投基金、中银基金、中金基金、淳厚基金、华富基金、华夏未来  交银理财、安盛天平财险、生命资管、平安养老、百年人寿、中信建投资管、中天国富证券、华安资产、民生信托、广发资管、中天证券、东吴资管、光大资管、财信证券、长江资管、永安期货资管、高腾国际、Fidelity  聚鸣投资、敦和资产、泓澄投资、顶天投资、拾贝投资、南方天辰、尚诚资产、同犇资产、域秀资本、景泰利丰、盛宇投资、上海恒复投资、红华资本、华银基金、红筹投资、和信金创

时间	2021年4月15日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：蒋威 证券事务代表：王渝
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>一、2020年度及2021年第一季度经营情况介绍</b></p> <p>回复：2020年贸易摩擦和新冠疫情对公司生产经营产生比较大的影响，疫情对全年的生产周期造成约25天的影响，相当于少了近一个月的收入和利润。2020年全年营收40.34亿元，同比增长6%；净利润5.21亿元，同比增长78%，扣除上海泽丰股权转让的投资收益2.26亿元，扣非净利润为2.92亿元，同比增长13.6%。2020年Q3是整个行业和公司的低潮，Q4对公司而言是一个比较明显的经营拐点。2021年一季报预告显示，整体净利润为0.9~1.1亿元，同比增长129%~180%，非经常性损益造成-800万元影响，主要是在需求回暖和产能释放的背景下，收入规模增长，经营效率提升导致成本费用率下降和盈利能力提升。</p> <p>从产品看：PCB业务增长5.6%，半导体业务增长4.6%。从区域看：国内整体情况要优于国外，主要受益于国内疫情得到较好的控制，国内增长13.7%，海外下滑0.5%，剔除汇率因素后，海外收入和利润都实现增长。从经营效率看，PCB业务毛利率32.57%，小幅提升0.64个百分点；半导体测试板毛利率26.69%、下滑1.23个百分点，主要与上海泽丰出表有关；IC封装基板业务毛利率13%、下滑4.68个百分点，主要受新产能投产因素影响。三项费用率（管理费用率+销售费用率+财务费用率）合计14.6%，较去年下降1.5个百分点，公司降本增效控费措施的成效比较显著。2020年研发投入较2019年增加4000万元，研发费用占收入比例达到5.92%，主要投入在相对较高附加值高技术的产品，比如高密度超薄封装基板、高端半导体测试板、400G光模块和5G天线板。</p> <p>2020年扣非净利润为2.92亿，非经常性损益为2.29亿。新产能投放、汇兑损失、新增研发投入和商誉减值等对经营性利润形成部分拖累。样板和IC封装基板的新产能投放亏损约4,500万元，全年汇兑损失3,700万元，研发多投4,000万元，子公司湖南源科商誉减值1,073万元，这</p>

些因素对净利润的影响约 1.3 亿元左右，实际上影响的是经营性利润。

从 2020 年 Q4~2021 年 Q1 的经营数据来看，整体效率有进一步的提升，成本管控的效果比较明显。

## **二、IC 封装基板产能？之前是否都是满产状态？**

回复：IC 封装基板现有产能 2 万平米/月，分两期投资建设，2012 年投产 1 万平米/月，2018 年底已经处于满产状态。2018 年扩产 1 万平米/月产能，原计划在 2020 年 Q1 投产，但因疫情影响装机进度，到 2020 年 6 月才开始试生产。到 2020 年底，达到 90%左右的产能利用率，整体的良率也提高至 96%以上。2021 年除了春节这个月之外，今年基本上处于一个满产的状态。

## **三、可转债刚性电路板项目的 1 万平米是否已经开始贡献收入？**

回复：去年下半年已经开始试生产，并开始贡献收入。

## **四、公司对半导体相关业务的占比在未来 3~5 年的规划是什么？**

回复：2020 年半导体业务收入占收入的比重已达到 20%以上，未来几年随着产能逐步释放，包括广州兴科 IC 封装基板项目和广州兴森半导体测试板项目的逐步投产，半导体业务占比会进一步提升。如果不考虑更远期的投资规划，广州兴科 IC 封装基板项目和广州兴森半导体测试板项目的产能完全释放之后，半导体业务的收入和利润占比预计会达到 50%左右。

## **五、公司整体的战略方向是什么？**

回复：自 1993 年公司成立以来，战略方向非常明确，一直专注于整个线路板产业链，通过自身的研发和积累，从传统的 PCB 领域进阶到半导体制程的半导体测试板和 IC 封装基板领域，实现产品、技术和客户的升级，未来公司仍会坚守线路板领域，专注于 PCB、半导体测试板和 IC 封装基板产品线，做精做大做强。资本开支会聚焦于高技术壁垒、高附加值的产品方向。在 PCB 领域，高端样板、高多层板是未来重点扩展的方向，不会再扩低层板。半导体业务重点是扩展 IC 封装基板和半导体测

	<p>试板的产能。</p> <p><b>六、IC 封装基板业务公司主要的定位是在哪些方向？</b></p> <p>回复:从行业竞争格局看，IC 封装基板主要还是日、韩、台等少数玩家参与，前 10 大占据了市场 80%以上的市场份额。公司在技术能力和客户资源上，相对日、韩、台的企业还是有一定的差距，所以就意味着公司进入赛道必须采取本土化或者是差异化的经营策略。</p> <p>从行业发展趋势而言，IC 封装基板行业景气度非常高，尤其是高端的 FCBGA 基板持续缺货、涨价，主要厂商 AT&amp;S、臻鼎、欣兴、景硕、南亚等都在加大投资力度扩充 FCBGA 基板的产能。根据 Prismark 预测,2021 年 IC 封装基板行业增长 19%左右、市场规模达到 122 亿美金，2020-2025 年复合增长率 9.7%，整体市场规模将超过 160 亿美金，超越 FPC 成为线路板领域最大的细分子行业。公司将进一步加大投资力度，持续扩充现有 IC 封装基板的产能，进一步提升公司的行业地位。</p> <p>从产品结构而言，配套 CPU/GPU 芯片的 FCBGA 基板（ABF 材料）增速会相对较快，也是市场规模最大的一个细分领域，公司也在储备进入该市场，但目前的能力尚不完全具备，到形成收入和利润贡献还有较长的时间。公司的 IC 封装基板产品是仍主攻存储芯片领域（BT 材料），存储领域的收入占比达 2/3，除原有存储芯片客户之外，随着长江存储、合肥长鑫的逐步上量和未来可预期的持续投资扩产，国内的市场空间将持续扩张，对于公司而言，面临很好的发展机遇；同时，公司也逐步开拓射频、MEMS 等市场领域的客户，进一步完善公司的产品线和客户群体。</p> <p><b>七、兴科半导体的股权当前公司占比为 41%，后续公司如何规划？</b></p> <p>回复：IC 封装基板是公司未来重点发展的战略业务，关于兴科半导体股权后续安排，公司会与投资方按照投资协议的约定履行退出安排。</p>
<p><b>附件清单</b> (如有)</p>	
<p><b>日期</b></p>	<p>2021 年 4 月 15 日</p>